

审计论文的摘要(实用5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

审计论文的摘要篇一

- 1、本论文(设计)是在指导教师的指导下，查阅相关文献，进行分析研究，独立撰写而成的。
- 2、本论文(设计)中，所有实验、数据和有关材料均是真实的。
- 3、本论文(设计)中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或机构已经撰写发表过的研究成果。
- 4、本论文(设计)如有剽窃他人研究成果的情况，一切后果自负。

毕业论文(设计)作者签名：

签字日期：年月日

毕业论文(设计)版权使用授权书

签字日期：年月日

签字日期：年月日

论文作者签名： 指导教师签名：

审计论文的摘要篇二

- 1、本论文(设计)是在指导教师的指导下, 查阅相关文献, 进行分析研究, 独立撰写而成的。
- 2、本论文(设计)中, 所有实验、数据和有关材料均是真实的。
- 3、本论文(设计)中除引文和致谢的内容外, 不包含其他人或机构已经撰写发表过的研究成果。
- 4、本论文(设计)如有剽窃他人研究成果的情况, 一切后果自负。

毕业论文(设计)作者签名:

签字日期: 年 月 日

毕业论文(设计)版权使用授权书

签字日期: 年 月 日

签字日期: 年 月 日

论文作者签名: 指导教师签名:

审计论文的摘要篇三

英语论文摘要是研究论文的重要组成部分, 本文首先通过英语论文摘要的重要功能作用来阐明其重要性; 并且分析在进行英语论文摘要撰写工作中, 应把握摘要的两个主要特点-完整的语篇结构和精炼的语言, 进而通过实际例子的对比分析, 探讨如何把握摘要的主要特点之一-其完整的语篇结构。

审计论文的摘要篇四

各位老师：

你们好！我叫徐峰，来自计算机12-4。我的论文题目是《在线考试系统》，论文是在徐燕妮老师的指点下完成的，在这里我向徐老师表示深深的谢意，向参加我的论文答辩各位老师表示衷心的感谢，并对我三年来的各位授课老师表示由衷的敬意。下面我将本论文设计的目的和主要内容向各位老师作一汇报，请各位老师批评指导。

首先，我想谈谈这个毕业论文设计的目的及意义。设计编写在线考试系统是基于以下几种目的：一是充分利用现有的计算机资源提高组卷效率，减轻工作人员的劳动强度；二是摒弃传统的手工整理、以试卷(纸质)的形式存放到档案室，浪费大量纸张等原材料不利于环境的保护。作为计算机应用的一部分，在线考试系统能对试题实行科学的管理，通过科学合理的组卷策略，减轻任课教师组织试卷的工作负担，避免人工组卷过程的主观性和片面性。保证同一教学大纲指导下多班级考试的公平性。

第一章前言，阐明了系统开发的目的是和意义。

第三章系统设计，确定系统总体结构和物理方案

第五章系统的运行与维护，介绍了系统的运行环境和维护方法

(1) 系统应用程序维护 (2) 数据维护 (3) 代码维护 (4) 硬件设备维护

(1) 纠错性维护 (2) 适应性维护 (3) 完善性维护 (4) 预防性维护

第六章结束语，是整个设计的总结。说明了该设计取得的成

果和存在的问题

最后，我想谈谈这篇论文和系统存在的不足。由于本人思维逻辑性不够严谨以及个人技术的不足使系统运行时偶尔出现错误，而且帮助模块也未能完善，在这篇论文的写作以及系统开发的过程中也使我认识到自己知识与经验的缺乏。虽然我竭尽所能进行论文写作和系统开发，但论文还是存在许多不足之处系统功能并不完备，有待改进。请各位评委老师多批评指正让我在今后的学习中学习到更多。

谢谢！

审计论文的摘要篇五

在查阅大量文献的基础上, 本文就价格促销对品牌权益的影响进行了分析。

同时, 也总结了国内外学者对在不同调节因素影响下, 价格促销对品牌权益影响的研究结论, 并提出了今后的研究的方向。

论文题目：天体对地球重力加速度的影响

论文摘要：地球重力加速度是一个极其重要的物理量，随着对重力加速度测量精度要求的日益提高，必须考虑天体对地球重力加速度的影响。

本文介绍了天体(包含日、月及太阳系行星)对地球重力加速度影响的基本概念，推导了影响的计算公式，并经过误差分析，证明此公式的相对误差小于 1×10^{-9} ，完全可满足现代精密重力加速度测量的要求。

撰写论文摘要的常见毛病，一是照搬论文正文中的小标题(目录)或论文结论部分的文字;二是内容不浓缩、不概括，文字篇幅过长。

论文摘要【1】

论文题目：集成电路热模拟模型和算法

论文提要：众所周知，半导体器件的各种特性参数都是温度的灵敏函数学[诸如 $l, b(t), c_1(t), c_p(t), \dots$.]

集成电路将大量元件集成在一块芯片上，电路工作时，元件功耗将产生热量，沿晶片向四周扩散。

但是由于半导体片及基座材料具有热阻，因此芯片上各点温度不可能相同。

特别对于功率集成电路，大功率元件区域将有较高温度的所以在芯片上存在着不均匀的温度分布。

但是为了简化计算，一般在分析集成电路性能时，常常忽略这种温度差别，假定所有元件者处于同一温度下。

例如通用的电路模拟程序--spice就是这样处理的。

显然这一假定对集成电路带来计算误差。

对于功率集成电路误差将更大。

因此，如何计算集成电路芯片上的温度分布，如何计算元件温度不同时的电路特性，以及如何考虑芯片上热、电相互作用，这就是本文的目的。

本文介绍集成电路的热模拟模型，并将热路问题模拟成电路问题，然后用电路模拟程序求解芯片温度分布。

这样做可以利用成熟的电路分析程序，使计算的速度和精度大为提高。

作者根据这一模型和算法，编制了一个ym-lin-3的fortran程序，它可以确定芯片温度分布，也可发计算元件处于不同温度时的电路特性，该程序在微机ibm-pc上通过，得到满意结果。

上述论文提要字数近600，显然过长，只要认真加以修改(例如：第一段可删掉，第二段只保留其中的最后几句话，加上第三段)，便可以二三百个字编写论文摘要。